



## **CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA** **“CÁTEDRAS CHIP”**

### **LISTADO DE SOLICITUDES PROVISIONALMENTE NO ADMITIDAS**

En cumplimiento de lo establecido en el número uno del apartado decimocuarto de la Convocatoria de las ayudas de Cátedras Chip, regulada por la Orden ETD/832/2023, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la creación de cátedras universidad-empresa (Cátedras Chip), destinadas a la investigación y desarrollo en el área de microelectrónica, para la difusión del conocimiento y la formación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, -financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, y tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se publica el siguiente listado (Anexo) con las solicitudes provisionalmente no admitidas.

De acuerdo con el número dos del apartado decimocuarto de la citada convocatoria, se requiere a las entidades que figuran en el citado Anexo para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde la publicación del presente listado, subsanen la solicitud.

Para realizar la presentación de la documentación requerida, deberá acceder a su expediente a través del registro electrónico. Utilizando el botón "Presentar documentación" accederá al formulario de "Envíode documentación" que le permitirá aportar dicha documentación.

Le rogamos que no adjunte documentación que no le haya sido requerida, ya que no será tenida en cuenta.

De no producirse la subsanación en el plazo mencionado, se le tendrá por desistido de su solicitud, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.





De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Jurídico Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente publicación tiene todos los efectos de notificación practicada. Adicionalmente y con carácter puramente informativo, esta publicación ha sido comunicada individualmente a los interesados.

Firmado electrónicamente por D. Francisco Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales

## ANEXO

### RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE AYUDA ADMITIDAS A LA FASE DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA

	EXPEDIENTE	TÍTULO PROYECTO	UNIVERSIDAD	CIF
1.	TSI-069100-2023-001	USECHIP: Cátedra En Microelectrónica De La Universidad De Sevilla	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Q4118001I
2.	TSI-069100-2023-004	SOC4SENSING Diseño System-on-Chip con sensores especializados y formación asociada	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	Q4818001B
3.	TSI-069100-2023-005	KATUTXIPI	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	Q2818029G
4.	TSI-069100-2023-011	Cátedra Chip Cantabria	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	Q3918001C
5.	TSI-069100-2023-012	CÁTEDRA DE MATERIALES AVANZADOS PARA LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	Q4618001D
6.	TSI-069100-2023-013	MALAGA MICROELECTRONICS	UNIVERSIDAD DE MALAGA	Q2918001E
7.	TSI-069100-2023-016	Cátedra UPM-INDRA en microelectrónica (CAUPIME)	UNIV.POLITECNICA DE MADRID	Q2818015F





**RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE AYUDA NO ADMITIDAS A LA FASE DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR REQUERIR SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN**

	<b>EXPEDIENTE</b>	<b>TÍTULO PROYECTO</b>	<b>UNIVERSIDAD</b>	<b>CIF</b>	<b>DOCUMENTOS QUE REQUIEREN SUBSANACIÓN</b>
1.	TSI-069100-2023-002	Cátedra chip fotónico de la Universitat Politècnica de València (Cátedra PIC-UPV	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	Q4618002B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acuerdos con terceros: Falta documento</li> </ul>
2.	TSI-069100-2023-003	+QCHIP: Transformando la Industria de Semiconductores a través de la integración monolítica de Circuitos CMOS y Tecnologías Innovadoras.	UNIVERSIDAD DE GRANADA	Q1818002F	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acuerdos con terceros: Falta document</li> <li>▪ Declaración de intenciones: Faltan firmas de los representantes de las entidades: 1.- ATISoluciones Diseño de Sistemas Electrónicos SL; 2.- Fundación Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia – Gradient; 3.- HOP UBIQUITOUS S.L., 4.- SaxonQ GmbH; 5.- GRAPHENEA SEMICONDUCTOR SLU; 6.- LASING S.A.- y 7.- Infinity Communication Tech Inc..</li> </ul>
3.	TSI-069100-2023-006	Tecnologías Avanzadas de Test, Ensamblaje y Encapsulado de Circuitos Integrados Electrónicos y Fotónicos- EPICPack	UNIVERSIDAD CARLOS3 MADRID	Q2818029G	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acuerdos con terceros: Falta documento</li> </ul>
4.	TSI-069100-2023-007	Acceso Abierto a Herramientas de testeo y caracterización de Chips Fotónicos y Electrónicos de Nueva Generación NEXTCHIP	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acuerdos con terceros: Falta documento</li> <li>▪ Declaración de intenciones: Faltan firmas de los representantes de las entidades: 1.- NAVANTIA; 2.- KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN SLU; 3.- Fundació Institut Des Ciencies</li> </ul>





Fotoniques (ICFO) y 4.- AIMEN					
5.	TSI-069100-2023-008	Cátedra Universidad-Empresa EPIQ: Circuitos electrónicos y fotónicos Integrados para tecnologías cuánticas	UNIVERSIDAD CARLOS3 MADRID	Q2818029G	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con terceros: Falta documento</li> </ul>
6.	TSI-069100-2023-009	Cátedra Internacional UPV-VaSiC de Diseño Microelectrónico, hacia el Campus Internacional de Semiconductores	UNIV.POLITECNICA DE VALENCIA	Q4618002B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con terceros: Falta document</li> </ul>
7.	TSI-069100-2023-010	Cátedra Televés en Diseño Microelectrónico	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con terceros: Falta documento</li> </ul>
8.	TSI-069100-2023-014	Cátedra Chip UCLM sobre Diseño de Sistemas Microelectrónicos basados en Arquitecturas Abiertas (DMA2)	UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	Q1368009E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con terceros: Falta documento</li> </ul>
9.	TSI-069100-2023-015	Chips para Arquitecturas Avanzadas y Sistemas Fotónicos (CAASFO)	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con terceros (falta documento)</li> <li>Declaración de intenciones (falta firma representante NXP Semiconductors Spain S.L.)</li> </ul>
10.	TSI-069200-2023-016	Diseño Microelectrónico de Sensores Inalámbricos sin Batería	UNIVERSIDAD DE NAVARRA	R3168001J	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos con terceros: Falta documento</li> </ul>

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden ETD/832/2023, de 18 de julio y en la “GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE CÁTEDRAS UNIVERSIDAD - EMPRESA (CÁTEDRAS CHIP)”, accesible en [https://portalayudas.mineco.gob.es/catedras-chip/Solicitudes/Documents/00Manual\\_Formulario\\_Solicitud-CATEDRAS\\_CHIP.pdf](https://portalayudas.mineco.gob.es/catedras-chip/Solicitudes/Documents/00Manual_Formulario_Solicitud-CATEDRAS_CHIP.pdf), el documento “Acuerdos con terceros” deberá aportar “referencia de





todos los acuerdos con terceros que se mencionen en la memoria de proyecto subvencionable. La referencia deberá incluir información suficiente para poder determinar:

- Identificación unívoca de los firmantes del acuerdo.
- Compromisos de las partes y su relación con el proyecto presentado por el interesado
- Aportaciones de cada una de las partes.

Así mismo, en el caso de la subsanación de las firmas en las declaraciones de intenciones de los representantes de las entidades participantes en los proyectos de los expedientes de las Universidades de Granada (TSI-069100-2023-003), Vigo ( TSI-069100-2023-007) y Politécnica de Cataluña (TSI-069100-2023-015), hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de las bases reguladoras de la convocatoria de Cátedras Chip aprobada por la Orden TRD/832/2023 (citada) y el apartado decimocuarto de la resolución de convocatoria de las mismas, la subsanación habrá de limitarse a la firma de la declaración de intenciones tal y como está formulada, sin que sea admisible como subsanación cualquier alteración o modificación de su contenido.

